

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】令和5年1月27日(2023.1.27)

【国際公開番号】WO2021/230226
 【出願番号】特願2022-521922(P2022-521922)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1 / 1 4 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 1 P 1 / 0 4 (2 0 0 6 . 0 1)

【 F I 】

H 0 5 K 1 / 1 4 C

H 0 1 P 1 / 0 4

10

【手続補正書】

【提出日】令和4年10月20日(2022.10.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0049

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【0049】

また、回路部は、接続部 Re Jよりも、回路基板に占める割合が大きいことが多い。したがって、回路基板20としても、上述の作用効果が得られるとともに、特性インピーダンスの変化を抑制し、電磁シールド性を高めることができる。すなわち、この構成では、特性インピーダンスの変化を抑制し、電磁シールド性を高めながら、回路部よりも意図しない変形や界面の剥離が生じ易い接続部 Re J に対して、意図しない変形や界面の剥離を抑制できる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0057

【補正方法】変更

【補正の内容】

30

【0057】

(第1の実施形態の変形例)

本発明の第1の実施形態の変形例に係る基板接合構造について、図を参照して説明する。図4は、第1の実施形態の変形例に係る回路基板25の接続部の平面図である。

40

50